



鈦昇科技股份有限公司

公司簡介及主要業務與產品

鈦昇公司設立於民國 83 年 10 月，目前資本額新台幣 447,090 仟元，主要從事 IC 封裝製程中雷射打印機（Laser Marking）、電漿清洗機（Plasma Cleaning）以及軟板沖切壓著設備之研發、製造、銷售業務。鈦昇公司掌握電漿、雷射、視覺檢測（AOI）、精密點膠等核心技術，並在 IC 封裝、LED 封裝、FPC 製造及觸控面板製造等領域提供相關核心技術產品，尤其是在雷射打印機、切割、鑽孔以及軟性電子材料製程（Roll to Roll）方面，已成為國內少數具獨特能力之技術服務團隊。

鈦昇公司大陸轉投資事業－東莞鈦昇半導體材料有限公司及無錫鈦昇半導體材料有限公司則從事電子包裝材料（Carrier Tape）業務，產品涵蓋導電級、非導電級 PC 及 PS 原料製成，並提供客戶委託設計與製造各式包裝載帶，提供 LED 半導體、被動元件等產業高品質電子包裝材料。

經營理念

以永續經營、利潤共享、創造股東及員工價值極大化之經營理念積極拓展新興市場；以主動積極提升品質，求新突破創造價值之品質政策強化品質之改善及客戶之滿意度。

經營實績

- 通路佈建完善，銷售層面廣，自動化設備已成功進入全台主要封裝測試廠，尤其以雷射蓋印機佔有率達 50%~60% 間為佳。
- 研發能力強，鈦昇公司秉持研發為基本競爭力原則，持續投入研發成本，以維持產品在市場之領導地位，累積之成果極為豐碩，不僅對客戶之需求皆可滿足，尚獲國外大廠肯定共同合作發展具競爭力產品。
- 自動化設備已由末端蓋印及切割機往前邁進，電漿清洗機市場亦逐步獲得國內大廠使用。
- 通過 ISO9001 驗證，品質完善，深獲客戶信心。

未來展望

- 建立國際銷售通路及供應鏈，以提升市場佔有率。
- 掌握市場動向，配合客戶需要，合作開發新產品並導入市場，提高產品品質並擴大市場規模。
- 持續研發新設備，保持競爭優勢之領先。
- 因應擴充需要，充分利用資本市場，降低資金成本，發揮最大資金運用效益。
- 面對產業環境快速變遷，不斷尋求內部改造，全面提升核心競爭力，並積極開創具潛力之產品，以期擴大營業業績及獲利目標。